

产品介绍

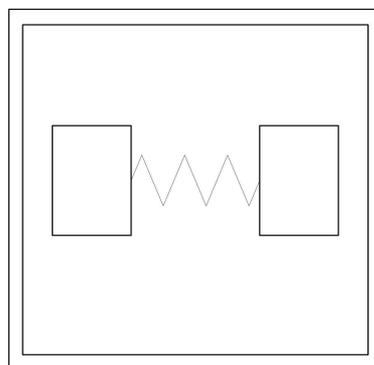
YR02-3060SC1 为 GaAs MMIC 电阻，耐电流值 $1\mu\text{m}$ 宽度对应 1mA。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘结工艺。

性能特点

- 尺寸小
- 可根据用户需求进行定制

应用领域

- 无线通信设备
- 雷达和电子对抗
- 军事和航天
- 测试测量
- 仪器仪表



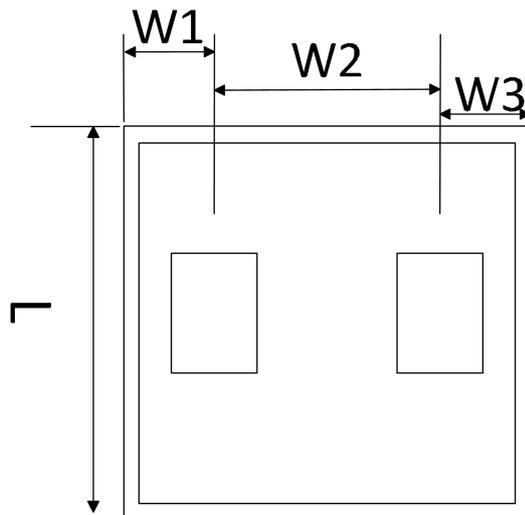
YR02-1030SC1 功能框图

极限参数

最大可承受电流	1mA/μm(W)
结温	175℃
储存温度	-65℃ ~ +150℃
工作温度	-55℃ ~ +125℃

注意：高功率应用时，请采用共晶烧结工艺安装芯片。

外形尺寸



说明：

- 1.单位：微米（μm）
- 2.芯片背面镀金
- 3.芯片背面接地
- 4.键合压点镀金，压点尺寸： 100×100(μm)
- 5.外形尺寸 公差：±50μm

电性能表 (TA =+25℃, 50Ω system)

型号	W1	W2	W3	L	标准阻值(Ω)
	μm	μm	μm	μm	1→2
YR02-3060SC1	100	700	110	534	300、500、600、1000、2000、4000、6000

阻值(Ω)	300	500	600	1000	2000	4000	6000
耐电流值 (mA)	50	30	25	15	7.6/10	3.7	3

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1,2	In,Out	任意两个端口均可以作为输入输出端口使用
	GND	芯片背面必须接地

装配图

